

特集3：外部技術の取得

特集3：外部技術の取得

今が時機と捉えて行った成長戦略に基づく買収



鷺野 憲治
取締役 専務執行役員
コーポレート開発本部担当、
ATS担当、FPD担当、PVE担当

当社は2012年に4件のM&Aを完了しましたが、それぞれの背景には異なる目的がありました。第一は「既存事業の強化」です。米国FSI International社の買収は、当社の核である半導体製造装置事業において最重要課題のひとつである洗浄装置の競争力を即時に高めることが狙いであり、既にその効果が始まっています。また米国NEXX Systems社の買収により半導体パッケージングの製品ラインアップが拡充し、複雑化

する顧客ニーズに応えるソリューションを幅広く提供できるようになりました。第二は「次世代コア技術の獲得」です。アイルランドのベンチャー企業であるMagnetic Solutions社の買収により、将来期待されている新しいタイプの半導体メモリの製造に必須となるユニークな技術を取得しました。第三は「事業領域の拡大」です。スイスOerlikon Solar社の買収により当社は本格的に太陽光パネル製造装置事業に参入し、中

長期的には中核事業に育てる計画です。M&Aにより取得した新たなリソースと、当社の持つ独自技術・世界各国の拠点ネットワーク・営業サポート力などを融合し、計画どおり統合作業を進めて

います。当社の参入する事業分野は秒進分歩の速さで技術革新が進んでおり、差別化された優れた技術をタイムリーに開発・製品化し市場に投入することが求められます。今後も、広い視野で柔

軟にM&Aや協業を検討することで、事業の強化および成長に努め、収益貢献につなげてまいります。

成長を目指した買収

目的	取得技術		買収完了時期
SPE 事業の強化	洗浄技術 ・枚葉洗浄装置	FSI International, Inc. (現 TEL FSI, Inc.)	2012 年 10 月
	先端パッケージング技術 ・電解めっき装置 ・スパッタリング装置	NEXX Systems Inc. (現 TEL NEXX, Inc.)	2012 年 5 月
SPE 事業 次世代コア技術の獲得	MRAM 製造技術 ・磁場中熱処理装置	Magnetic Solutions Ltd. (現 TEL Magnetic solutions Ltd.)	2012 年 12 月
新規事業への 進出	太陽光パネル製造技術 ・薄膜シリコン太陽光パネル製造装置	Oerlikon Solar AG (現 TEL Solar AG)	2012 年 11 月

FSI International社の買収

当社にない枚葉洗浄技術の補完で洗浄装置事業の拡大を狙う

従来からの製品ラインアップ

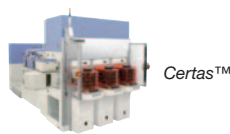
バッチ洗浄



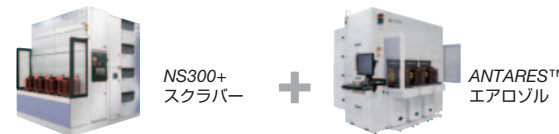
枚葉洗浄



ドライ洗浄



物理洗浄



今後重要性を増す高温SPM（硫酸過水混合液）によるハイドロズレジスト剥離装置を持つFSI International社の買収で、枚葉洗浄装置分野における競争力を強化していきます。

NEXX Systems社の買収

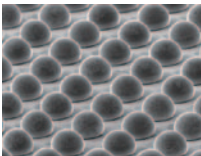
今後の成長ドライバーとなる先端パッケージング分野の製品ラインアップを強化する



Stratus 電解めっき装置



Cu pillar



Micro bump



TSV Cu埋め込み

先端パッケージング向け成膜装置（電解めっき装置、スパッタリング装置）メーカーであるNEXX Systems社の買収により、今後高成長が見込まれるTSV 3D積層技術向けの製品ラインアップが拡充されました。

TSV: through-silicon via